

# 株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 第2四半期 決算説明会

2023年11月2日

代表取締役会長 CEO	吉田 均
代表取締役社長 COO	木村 龍一
代表取締役副社長CFO	川村 浩一
取締役 計測社カンパニー長	塚田 修一

#### ◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

#### ◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

#### ◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## 次第

- ◆ 2023年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2023年度 通期業績予想
- ◆ 中期経営計画と今後の事業機会について
- ◆ 質疑応答

# 2023年度 第2四半期 連結業績



半期業績(億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前半期比	前年同期比
受注高	802	561	595		+6%	-26%
売上高	711	757	635	+25	-16%	-11%
営業利益 (営業利益率)	157 (22%)	188 (25%)	114 (18%)	+4	-39%	-27%
経常利益	166	187	121	+11	-36%	-27%
当期純利益	119	117	85	+5	-27%	-28%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	462	340	301	260	295	299	+1%	-12%
売上高	279	432	320	437	266	369	+39%	-14%
営業利益 (営業利益率)	57 (20%)	100 (23%)	74 (23%)	114 (26%)	43 (16%)	71 (19%)	+68%	-29%
経常利益	65	101	71	116	47	74	+56%	-27%
当期純利益	48	71	33	84	32	53	+63%	-25%

- 売上高は、民生品を中心に予想対比 上振れ
- 受注高は、前年同期比で減少も、下期比で微増

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 代表取締役社長COO の木村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは、2023年度上期ならびに、第2四半期の業績を説明させていただきます。  
2023年度上期は 民生品を中心に 減速傾向が強まり、  
前年同期比では減収減益ではあったものの、予想をやや上回る着地となりました。
- 第2四半期の業績は、下段に記載の通りです。  
前四半期比では増収増益となりました。
- 次に、セグメント別に説明いたします。

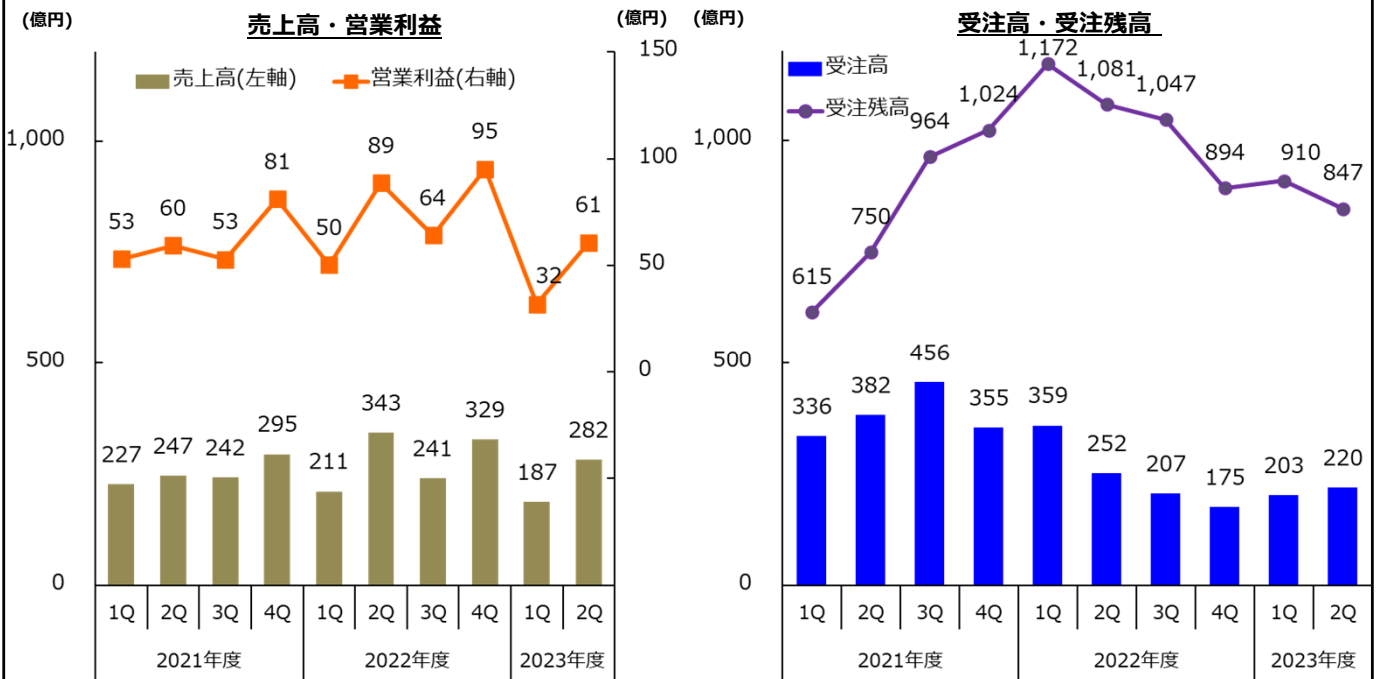
セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前半期比	前年同期比
受注高	612	382	423		+11%	-31%
売上高	554	570	470	+30	-18%	-15%
営業利益 (営業利益率)	139 (25%)	159 (28%)	93 (20%)		-42%	-33%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	+8%	-13%
売上高	211	343	241	329	187	282	+51%	-18%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	61 (22%)	+90%	-31%

- 受注高は、民生関係の需要が軟調に推移するも、前年下期比では増加
- 第2四半期の営業利益率は20%台に回復

- まず、半導体製造装置セグメントです。
- 上期の受注高ですが、民生関係の需要は、軟調なまま推移しましたが後ほど説明する要因により、前年下期比では増加いたしました。
- 売上高ですが、高水準の生産・出荷が続き、予想を上回りました。
- 四半期業績は、下段に記載の通りです。  
第2四半期の営業利益率は、20%台に回復いたしました。

# 半導体 - 四半期業績推移



- 売上高・営業利益：概ね高水準の生産・出荷を維持
- 受注・受注残高：民生軟調、SiCパワー系・生成AI案件が下支え

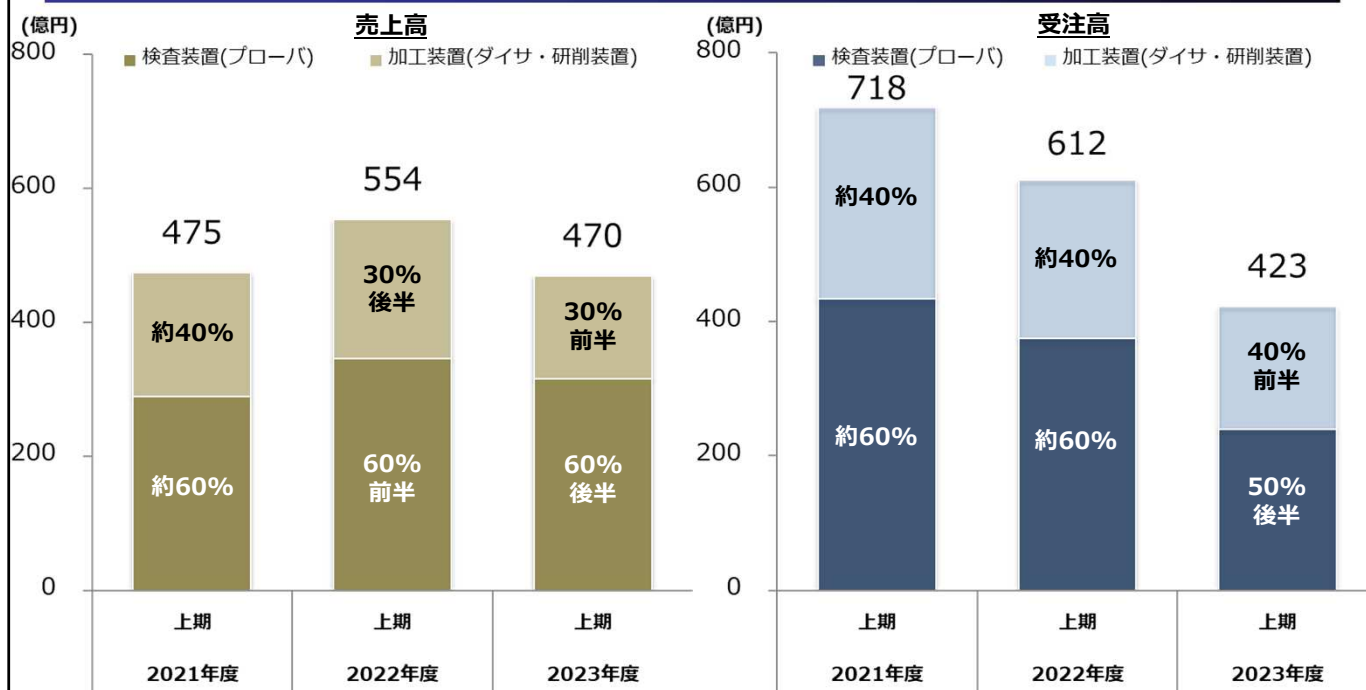
Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

6

- こちらは、売上高などの四半期推移です。
- 左側のグラフで、第2四半期の売上高ですが、従来より第2四半期寄りの出荷・売上計画であったところ、これがほぼ想定通り推移したほか、生産スロットの調整が滞りなく進みました。
- 右側、受注高ですが、民生関係は総じて軟調でした。その中でも、SiCパワー半導体や生成AI案件が下支えとなり、第1四半期比で増加いたしました。

# 半導体 - 製品別動向



- 売上高：構成比に大きな変化なし
- 受注高：加工装置の需要は相対的に安定

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

7

○ 半導体の 製品別売上高、並びに受注高はご覧の通りとなります。

○ 右側、受注高ですが、  
民生関係が軟調な中、研削装置の需要を中心に、加工装置の受注は  
相対的に安定して推移いたしました。

セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前半期比	前年同期比
受注高	190	179	172		-4%	-10%
売上高	157	188	166	-4	-12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	18 (11%)	29 (15%)	21 (13%)		-27%	+19%

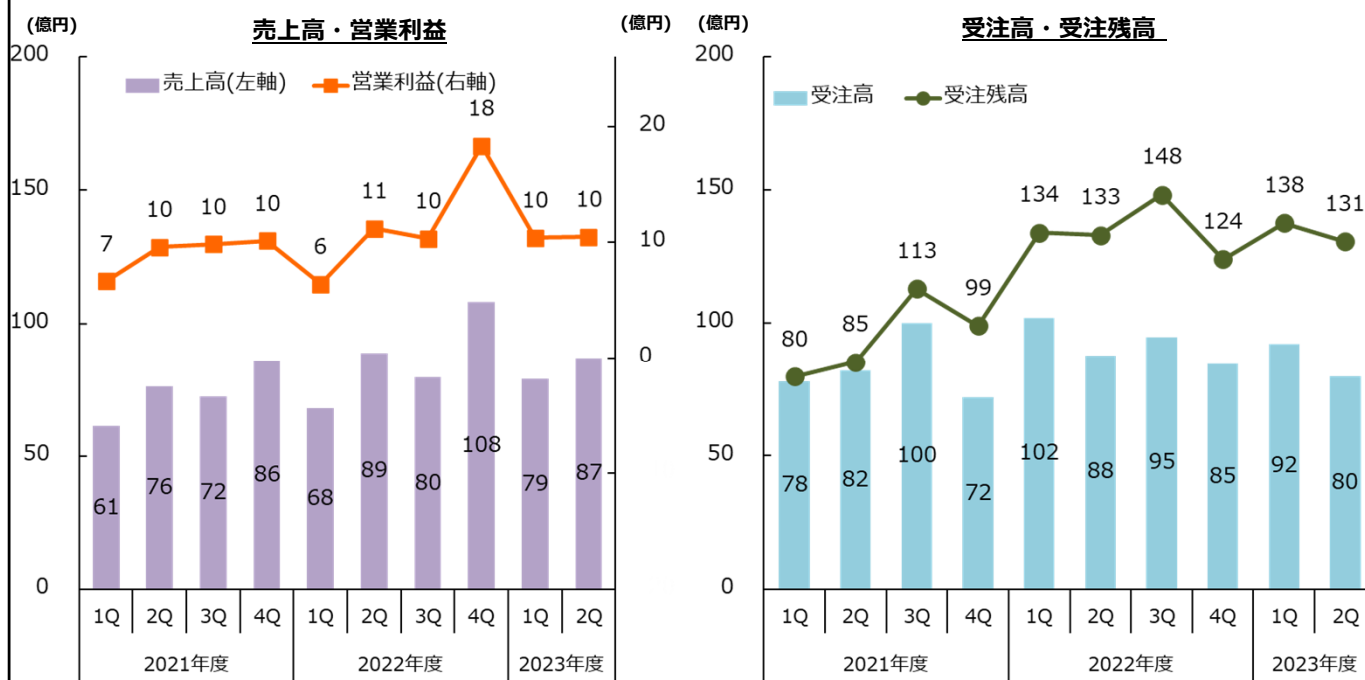
四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	-13%	-9%
売上高	68	89	80	108	79	87	+10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	10 (12%)	+1%	-6%

- 売上高は、概ね想定なみの着地
- 受注高は、マクロ環境を主因に 減少傾向

- 続いて、計測機器セグメントの説明です。
- 上期の売上高は、概ね想定通りとなりました。
- 一方、マクロ経済の不透明感から、  
主要なものづくり業界で、設備投資の先送り傾向が強まり、  
受注高は前年から減少いたしました。
- 第2四半期の業績は、下段に記載の通りとなります。



# 計測 - 四半期業績推移



➤ 売上高・営業利益：売上は概ね想定なみ

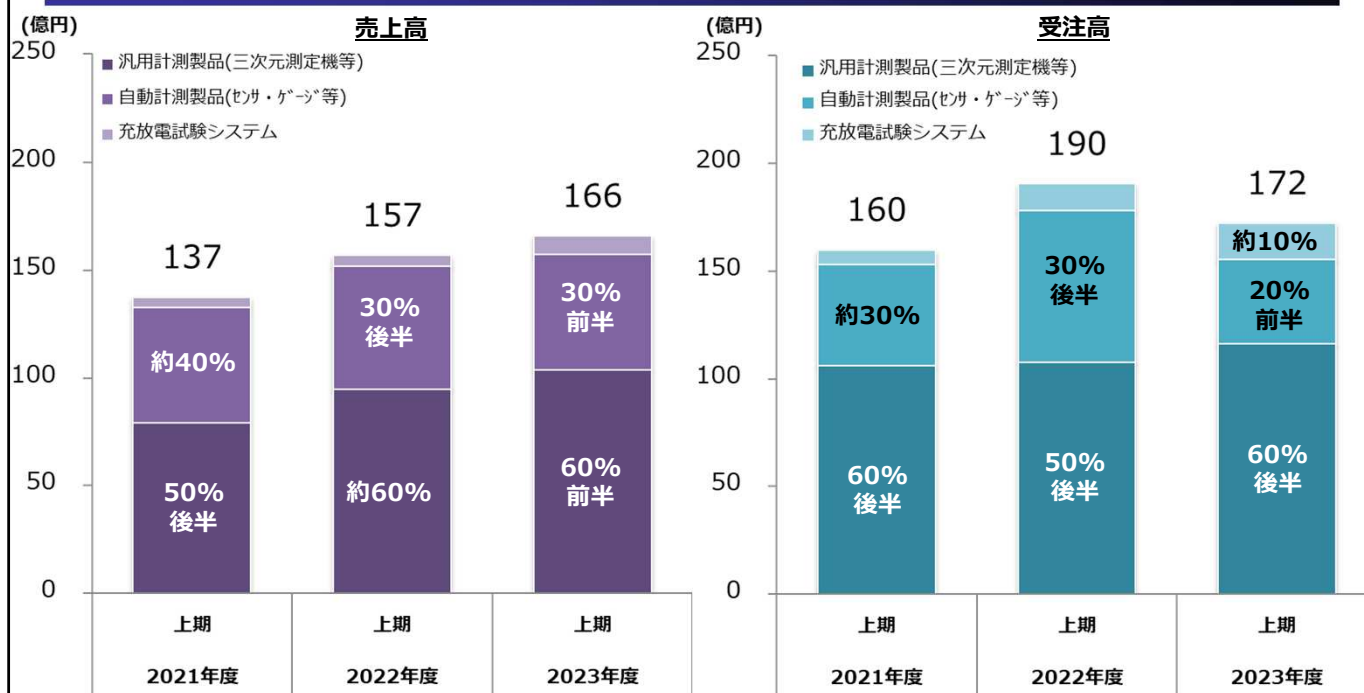
➤ 受注・受注残高：マクロ経済の不透明感はあるが、EV関連の受注は増加

○ こちらは、計測の四半期推移グラフです。

○ 左側、売上高ですが、  
第2四半期は、概ね想定通りの出荷・売上となりました。

○ また右側、受注高についてですが、  
ものづくり業界全般に 軟調さがあるなか、EV関連の商談は増加いたしました。

# 計測 - 製品別動向



➤ 売上高：構成に大きな変化なし

➤ 受注高：全体的に調整傾向の中、充放電試験システムとEV向け汎用計測製品の受注が増加

○ 計測の製品別売上高、並びに受注高はご覧の通りです。

○ 右側、受注高ですが、全般に調整傾向がみられました。

特に、センサ・ゲージなどの自動計測製品が減少した一方で、

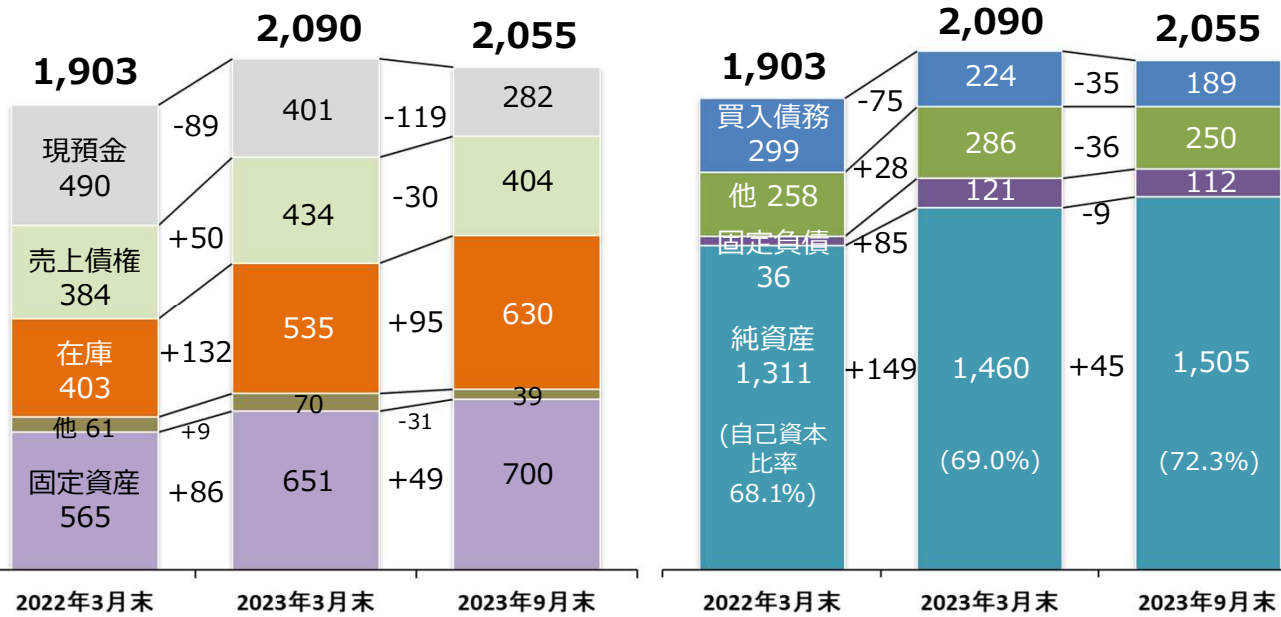
充放電試験システムや、EV部品向けの汎用計測製品の受注が増加いたしました。

# 貸借対照表



## 資産の部(億円)

## 負債・純資産の部(億円)



- 資産の部：今後の出荷を見越し、在庫が増加
- 負債・純資産の部：買入債務が減少(サイト短縮による)

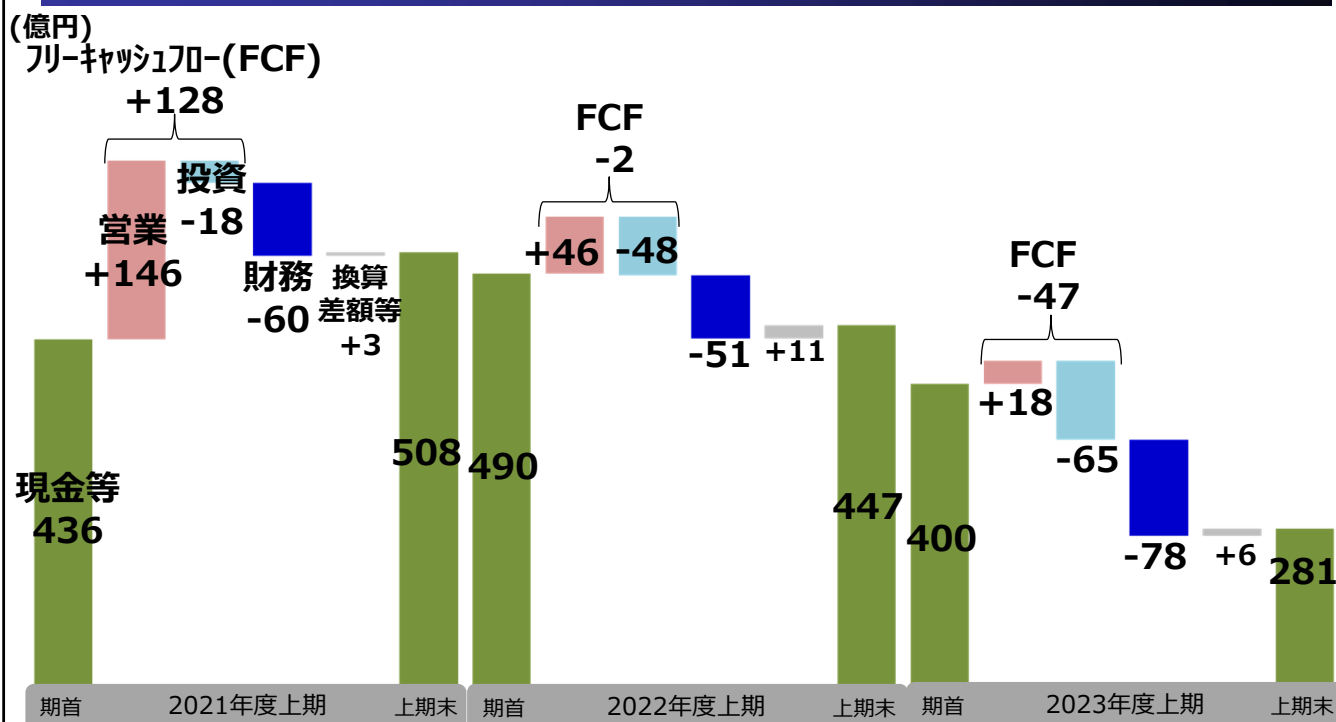
Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

11

- こちらは貸借対照表の概要となります。
- 2023年9月末の総資産は、2,055億円となりました。
- 左の資産の部ですが、特に在庫が3月末比で増加いたしました。  
これは、今後の出荷に向けた在庫の増加も一因となっております。
- 右側、負債については、支払いサイトの短縮により、買掛金が減少いたしました。
- 9月末の自己資本比率は 72.3%となりました。

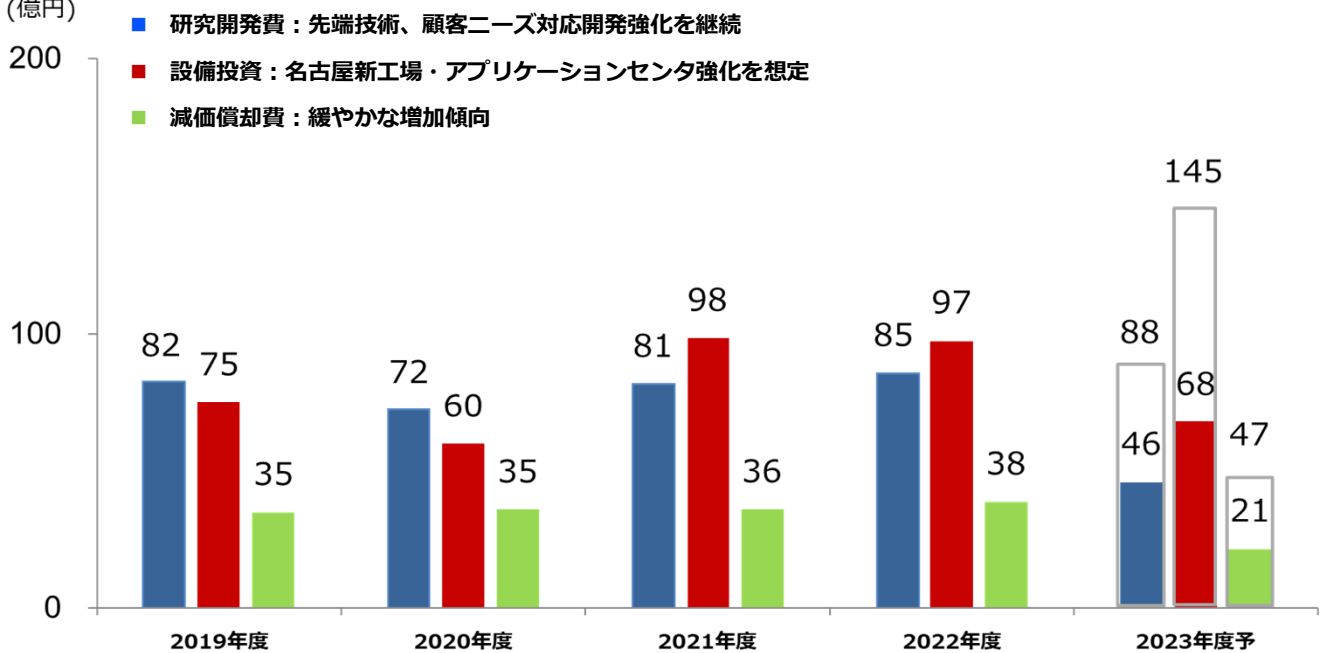
# キャッシュフロー(CF)



➤ FCFのマイナスは 在庫増加、設備投資が主因

- 次に、キャッシュフローについて説明いたします。上期実績を並べています。
- この上期のフリーキャッシュフローはマイナス47億円となり  
上期末の現預金残高は281億円 となりました。
- こちらは、今後の成長を見据えた設備投資を継続していることに加え、  
高い受注残を背景に、在庫が2期連続で増加したことによるものです。

(億円)



➤ 2023年度 研究開発費等の計画に変更なし

- こちらは、試験研究費や設備投資の実績推移と、今年度の計画となります。
- 試験研究費は、上期実績は46億円、ほぼラップ通りです。  
引き続き、開発強化に取り組んでまいります。
- 設備投資は、半導体の新工場やアプリケーションセンタへの投資が主体で、  
上期実績は68億円です。
- 減価償却の上期実績は21億円です。  
今後も減価償却はゆるやかに増加すると見込んでおります。
- ここまでが、2023年度 上期実績の説明です。

## 次第

- ◆ 2023年度 第2四半期 業績説明
- ◆ **2023年度 通期業績予想**
- ◆ 中期経営計画と今後の事業機会について
- ◆ 質疑応答

○ 続いて、2023年度通期業績予想について説明いたします。

## 全体

- 今後の成長を見据え 必要な研究開発・設備投資を継続

## 半導体

- 民生関連の需要は年度一杯低迷する見通し
- 堅調な分野 (AI、HBM、Hybrid Bonding、SiC、CIS、中国需要) が 短中期需要を牽引

## 計測

- 顧客の投資決定に先送り傾向あり
- 自動車向けはNEVの拡大を想定
- 非自動車分野への拡販や、自動化向けソリューション強化を進める

- こちらは 業績予想の前提となります。8月の説明会で開示した資料に、青字でアップデートを入れております。
- まず全体感ですが、足許の市場は軟調と捉えていますが、次のサイクルでは大きな成長が実現できると考えております。このため、成長に必要な研究開発・設備投資は計画通り進めてゆく所存です。
- 半導体については、民生向けの調整が継続しており、年度一杯は軟調と予想いたします。一方で、SiC、AIや中国での需要などの堅調な分野が受注の下支えとなるほか、高水準の受注残が、売上高を牽引していくと考えています。
- 計測では、様々な業界で設備投資の先送りの傾向がみられます。その一方で、成長が見込まれる NEV、非自動車分野への拡販を推進してまいります。

# 2023年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2022年度			2023年度予				
	上期	下期	通期	上期	下期予	通期予 (今回)	前回公表対比	前期比
売上高	711	757	1,468	635	685	1,320	+30	-10%
営業利益 (営業利益率)	157 (22%)	188 (25%)	345 (24%)	114 (18%)	131 (19%)	245 (19%)	+5	-29%
経常利益	166	187	353	121	133	254	+14	-28%
当期純利益	119	117	236	85	90	178	+8	-25%
1株配当	235円				178円		+8円	-57円

## セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	612	382	994	423				
	売上高	554	570	1,124	470	515	985	+45	-12%
(計測)	受注高	190	179	370	172				
	売上高	157	188	344	166	169	335	-15	-3%

- 2023年5月12日に公表した通期業績予想を修正
- 前回予想対比で半導体は増収、計測は減収を予想
- 為替前提は1ドル=130円→140円へ変更、影響は1ドル1円で 1.2億円(円安がプラス)

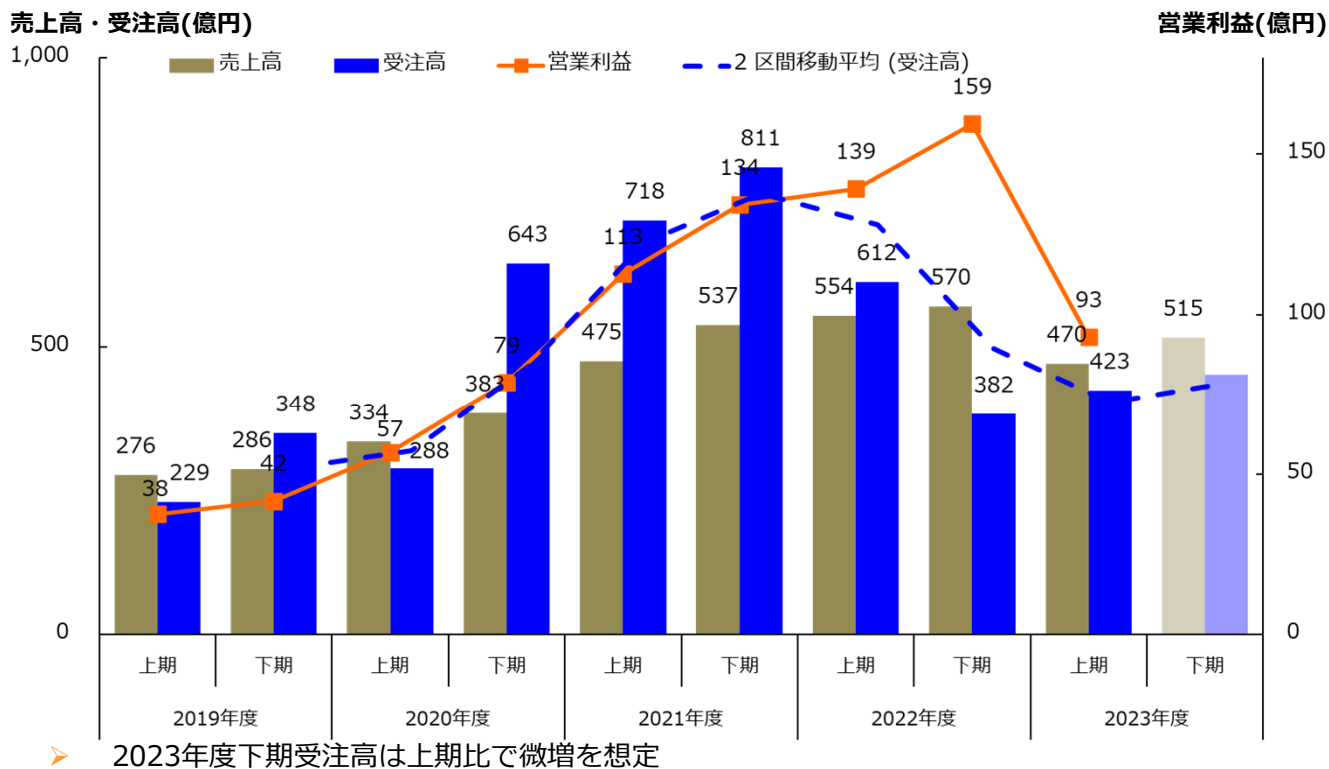
Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

16

- 以上を踏まえ、2023年度通期業績予想をご覧の通り修正いたしました。
- 具体的には、  
半導体で、SiCなどのパワー系需要や、生成AI関連需要が見込まれることから、売上高を、前回予想対比で45億円 上方修正した一方で、計測では、設備投資の先送り傾向を踏まえ、15億円 下方修正いたしました。
- これにより、利益面では 営業利益を5億円、経常利益を14億円、当期利益を8億円それぞれ上方修正いたしました。
- 年間配当予想も、1株当たり 8円増配の、178円に修正しております。
- なお、為替前提も、従前の 1ドル 130円から、140円へ変更しております。





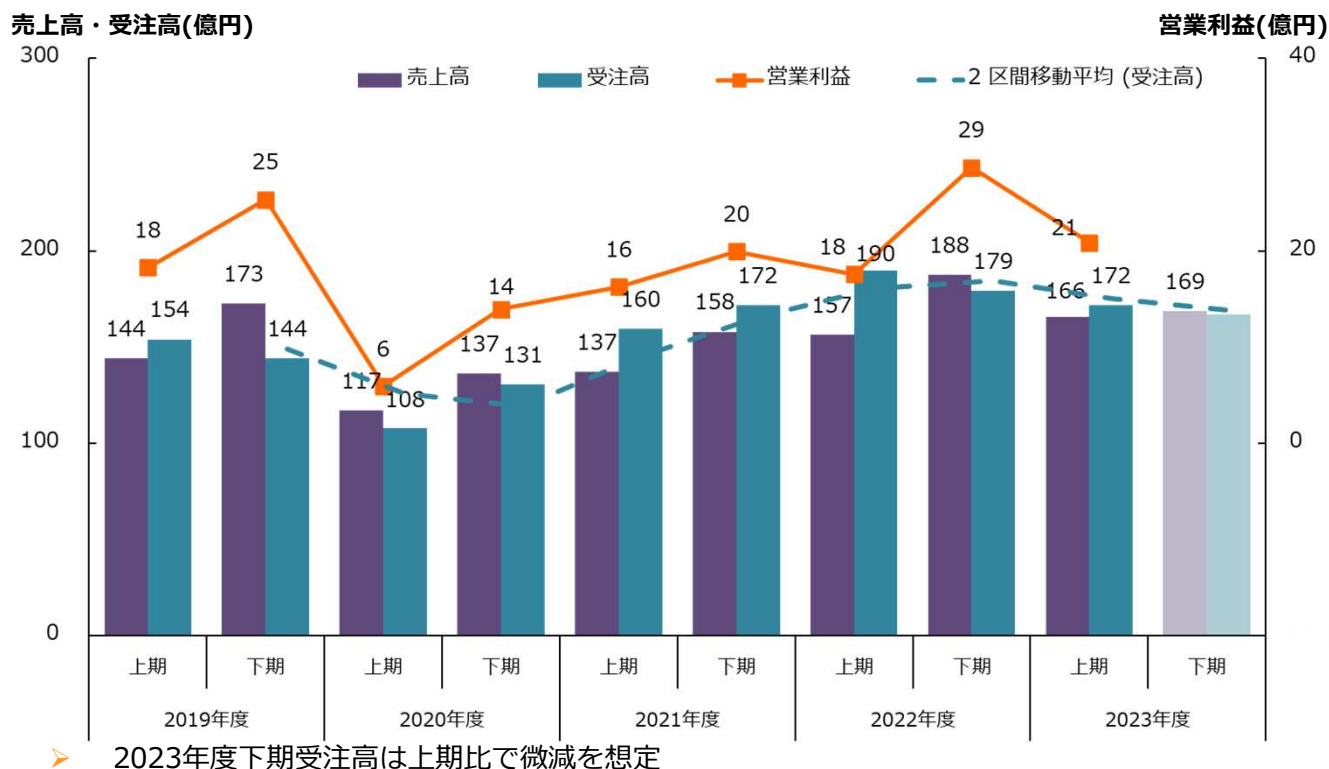
Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

17

- こちらは、半導体の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みとなります。
- この下期の受注高ですが、上期から僅かな増加を予想しております。  
民生案件は引き続き低調ながら、他の堅調な分野の受注が下支えになると想定しています。
- 下期予想の製品構成比は、  
受注高、売上高ともに、検査装置 6割、加工装置 4割を想定しております。

# 計測 - 売上高・受注高 見込



Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

18

- こちらは、計測の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- この下期の受注高については、上期と同様、やや停滞基調が続くと想定いたします。
- 下期予想の製品構成比は、  
 受注高は 汎用計測 7割、自動計測が 2割前半、充放電が 1割弱  
 売上高は 汎用計測 6割、自動計測が3割、充放電が 1割を想定しております。

## 次第

- ◆ 2023年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2023年度 通期業績予想
- ◆ **中期経営計画と今後の事業機会について**
- ◆ 質疑応答

- 次に、2024年度を最終年度とする 中期経営計画と今後の事業機会についてご説明いたします。

## ➤ 定量目標

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

## ➤ 全社取り組み

<b>研究開発投資</b> 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化	<b>生産キャパシティ拡充</b> 飯能工場稼働 (2023年度) SPEキャパシティ 1,400億+α その次の工場投資も検討	<b>環境投資</b> 2030年CO2排出量 50%削減 (2018年度比)に向け 必要な投資を検討
<b>投資評価指標</b> 社内評価基準にROICを検討	<b>アプリケーション強化</b> 各国拠点におけるデモ設備強化	<b>サステナビリティ</b> ESG各取り組み強化

- こちらは、中期経営計画の定量目標です。
- ROE15%以上、売上高 1,700億円、営業利益 375億円と設定いたしました。  
また、全社の取り組みを 下段にまとめております。

- 中期経営計画の前提市場として、民生エレクトロニクスのアップタームが2023年度に訪れる可能性を織り込んでいたが、当初の想定より停滞基調にある
- 一方で、新たな成長機会が認められ、2024年度以降のけん引役となる可能性がある
- このため、中期経営計画達成の確度は引き続き高いとみて必要な投資を継続する



- この中期経営計画の前提には、民生関連の需要サイクルも含まれており、当初は2023年度中に回復する可能性を織り込んでおりました。しかし、当初の想定より、停滞しております。
- その一方で、足許の生成AI需要などは、この中期経営計画の策定当初は織り込んでいなかった需要であり、またこの2, 3年で急速に拡大するものと考えられます。
- この需要を取り込むことで、中期経営計画の最終年度である2024年度には、定量計画の達成も十分可能と考えております。
- したがって、現時点では、計画の達成に必要な投資を継続していきます。

Hybrid bondingによる研削装置の成長

プローバ高精度温度制御 → 付加価値の拡大

SiC加工は基板主体からデバイス主体へ

半導体と計測の融合によるシナジー効果 2025年 130億円超

NEVバッテリーの飛躍的な個数成長

**AI関連の需要増加**

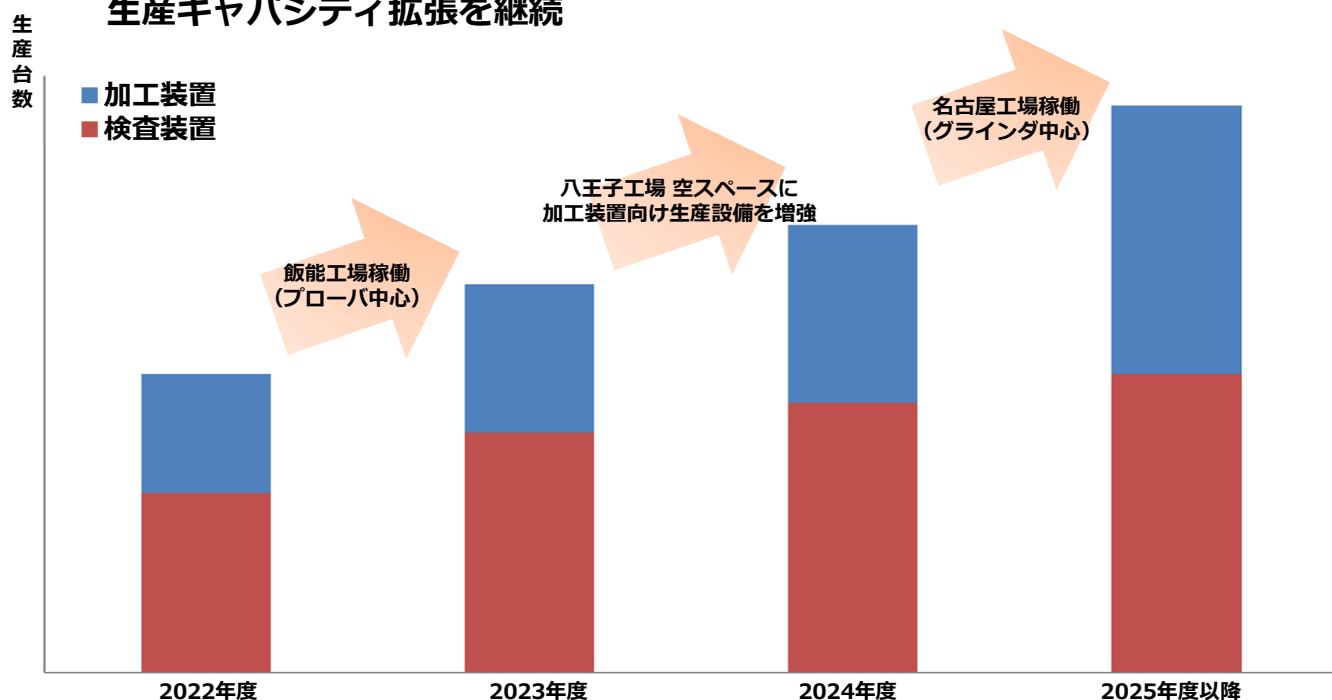
**地政学の変化による需要の増加**

- 当社の今後の成長機会として、  
ご覧の資料を5月に開示しておりますが、今回、項目を2つ追加いたしました。
- 具体的には、AI関連の需要増加と、地政学の変化による需要の増加になります。
- 次のページでこれらの機会を詳細に説明いたします。

要素	当社の事業機会・強み
SiC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 装置需要は 基板加工からデバイス加工へ</li> <li>● 高剛性グラインダ(HRG)、エッジグラインダ</li> <li>● ダイサ SiC専用ブレード、プローバ</li> </ul>
HBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プローバ HBM専用チャックによる高精度測定</li> </ul>
AI ロジック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高剛性グラインダ(HRG)</li> <li>● プローバ 高精度温度制御</li> <li>● ダイサ エッジトリミング・アブレーション</li> </ul>
Hybrid Bonding	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高剛性グラインダ(HRG)、CMP</li> <li>● 前工程と同等の洗浄機能提供</li> </ul>
地政学変化による需要	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中国 チップレット戦略への対応</li> <li>● 幅広い製品ラインアップ（ウェーハ製造～後工程）</li> <li>● グローバルサポート体制</li> </ul>
NEV バッテリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● X線CT技術（内部欠陥、異物検出、電極ギャップ計測）</li> <li>● 充放電試験システム</li> </ul>
半導体と計測の融合によるシナジー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導体製造装置“計測機器ビルトインモデル”</li> <li>● 高精度非接触測定機器</li> <li>● 半導体事業の販売・サービス網</li> </ul>

- まず、SiCの需要は基盤加工から より研削量が多いデバイス加工への移行が進み、当社の各種グラインダ、プローバ及び ダイサの事業機会が増えていくと想定されます。
- HBMに対しては、全方位戦略をとる当社のプローバは 高低温チャック等の技術仕様に対応していると考えております。
- AIロジックに関しては、グラインダ、プローバ及び ダイサの事業機会となり、アブレーションレーザーダイサも活かせると考えております。
- ハイブリッド・ボンディングに対しては、要求される研削精度に対応できる 高剛性グラインダに加え、当社でも確立している 洗浄技術で対応してまいります。
- 中国及び、「チャイナ プラスワン」等の地政学変化による需要に対しては、幅広い製品ラインアップ及び、グローバルなサポート体制で応えてまいります。
- NEVバッテリーについては、内部を検査するX線CT技術や、充放電試験システムが引き続き、今後の大きな事業機会となります。
- 半導体と計測の融合によるシナジーについては、両事業の装置の融合や、半導体事業の販売網を活かして半導体製造工程への販売促進を行ってまいります。

➤ 新素材、パッケージング技術の発展によるグライндаの需要増加を想定  
生産キャパシティ拡張を継続



Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

24

- 最後に、今後の生産キャパシティの動向についてご説明いたします。
- 半導体の需要増加に向けて、工場建設による生産キャパシティ拡張を進めてまいります。
- 今年7月には、フローバの生産を中心とした飯能工場が稼働しております。
- 現在は、飯能工場へ移行して空いた八王子工場内のスペースでの、加工装置の生産に向けた設備増強を進めております。
- こちらの増強を行うことで、中期経営計画の目標を達成できると考えております。
- さらに、SiC等の新素材、パッケージング技術の発展によるグライнда需要の増加を想定し名古屋にグライнда生産を中心とした工場を建設する予定です。
- 今後も半導体需要の増加を想定して、生産キャパシティを確保していく所存です。
- 私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。



## 次第

- ◆ 2023年度 第2四半期 業績説明
- ◆ 2023年度 通期業績予想
- ◆ 中期経営計画と今後の事業機会について
- ◆ **質疑応答**



### IR情報



<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

### サステナビリティ情報



<https://www.accretech.jp/sustainability/index.html>

# 補足資料

# Supplementary Data

サステナビリティレポート  
2023年9月25日 発行



統合報告書  
2023年10月30日 和文版発行  
2023年11月末 英文版発行予定



# セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938		
Backlog 受注残額	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771		
Sales 売上	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
OP 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	6,089		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,048		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	21.6%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	12.1%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%		

# 損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
売上原価 Cost of goods sold	53,452	60,190	77,694	84,967	15,940	25,783	18,220	25,022	15,415	22,387		
売上総利益 Gross Profit on Sales	34,474	36,914	53,008	61,834	11,978	17,372	13,817	18,664	11,203	14,531		
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,192	21,351	24,681	27,339	6,287	7,378	6,369	7,303	6,952	7,392		
営業利益 Operating profit	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,139		
営業外収益 Non-operating income	255	540	987	965	824	96	-229	274	563	245		
営業外費用 Non-operating expenses	177	235	153	162	18	25	111	7	103	22		
経常利益 Recurring Profit	12,360	15,867	29,160	35,297	6,496	10,065	7,107	11,628	4,710	7,361		
特別利益 Extraordinary gains	57	1,354	390	103	5	58	12	25	26	-		
特別損失 Extraordinary losses	1,712	1,074	34	2,099	-	-	1,751	347	-	14		
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	10,705	16,147	29,516	33,301	6,502	10,124	5,368	11,306	4,736	7,347		
法人税等合計 Total Income tax and others	3,598	3,978	8,132	9,607	1,660	3,019	2,011	2,916	1,456	1,998		
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	7,156	12,175	21,326	23,630	4,812	7,096	3,338	8,383	3,245	5,302		
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	171.89	293.83	522.52	581.33	118.38	174.47	82.05	206.60	80.63	131.49		
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	170.72	291.43	517.51	575.62	-	-	-	-	-	-		

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

30

# 貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(2Q末) FY2024/3 (2Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	43,657	49,033	40,080	28,154
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	30,946	38,367	43,403	40,442
	在庫 Inventories	32,886	40,325	53,482	63,029
	その他 Others	4,025	6,103	7,005	3,943
	合計 Total	111,516	133,829	143,972	135,570
固定資産合計 Total Fixed Assets		50,039	56,457	65,060	69,954
総資産 Total Assets		161,556	190,287	209,032	205,524
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	23,062	29,876	22,359	18,867
	その他 Others	16,233	25,765	28,588	24,968
	合計 Total	39,296	55,641	50,947	43,836
固定負債合計 Total long-term liabilities		5,482	3,564	12,057	11,155
負債合計 Total Liabilities		44,778	59,206	63,004	54,991
純資産合計 Total Net Assets		116,777	131,081	146,028	150,533
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		161,556	190,287	209,032	205,524
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		7,581	5,497	14,191	12,140
自己資本比率 Equity Ratio(%)		71.4%	68.1%	69.0%	72.3%
自己資本利益率 ROE(%)		10.9%	17.4%	17.3%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

# 各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows



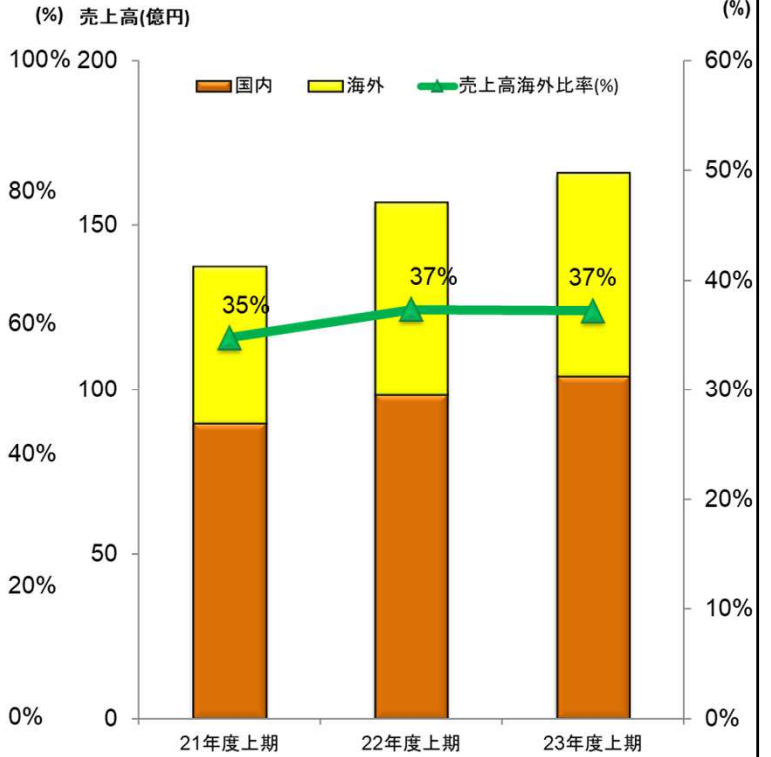
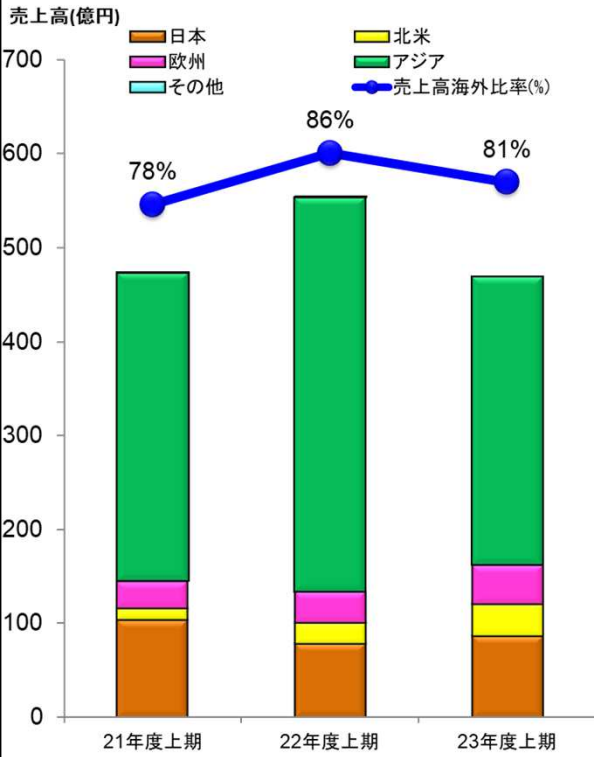
(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(2Q) FY2024/3(2Q)
試験研究費 R&D expenses	7,193	8,146	8,542	4,554
設備投資 Capex	5,950	9,793	9,725	6,764
減価償却費 (のれん除く) Depreciation (excl. Amortization)	3,516	3,551	3,832	2,100

(百万円) (Million Yen)	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期(2Q) FY2024/3(2Q)
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	22,062	23,837	1,000	1,832
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-5,191	-8,990	-8,421	-6,498
フリーキャッシュフロー Free cash flows	16,871	14,846	-7,421	-4,665
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-8,282	-10,346	-2,174	-7,821
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	429	882	625	559
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	43,624	49,006	40,036	28,108

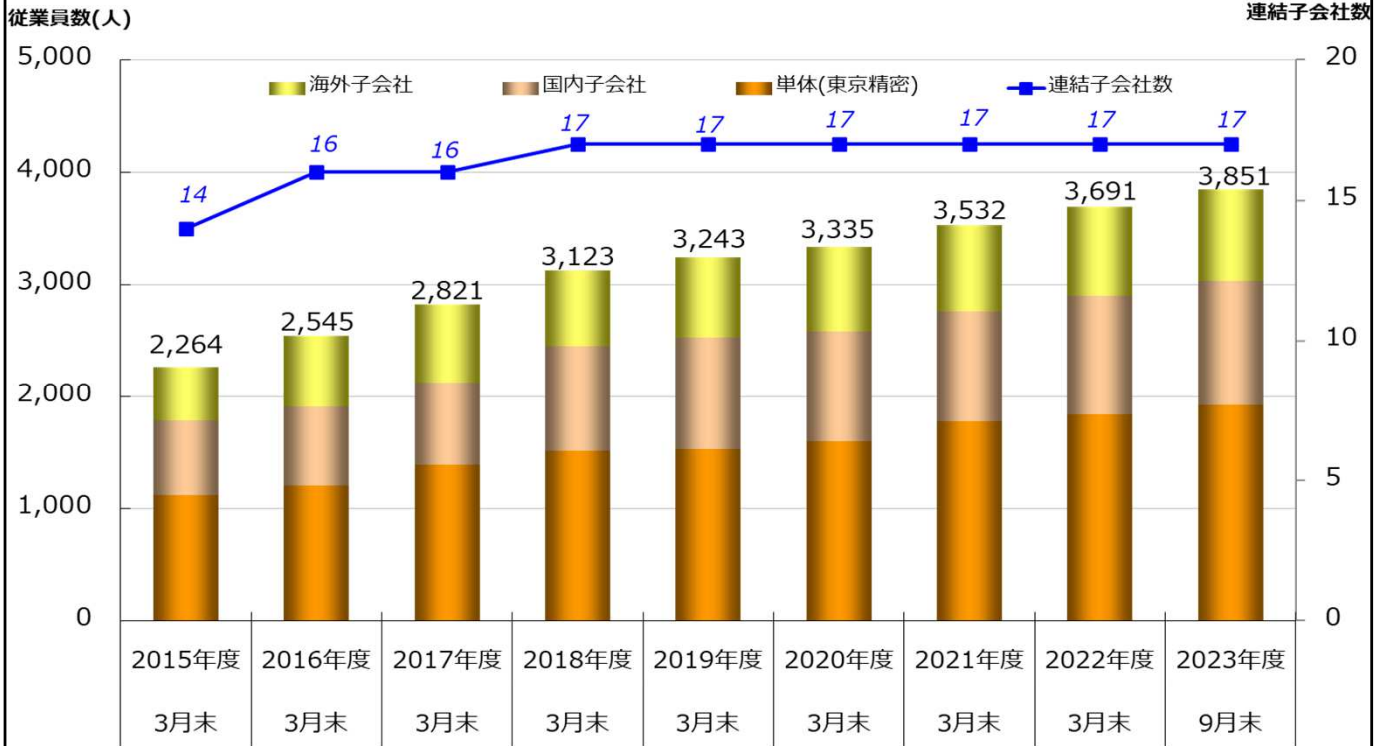


## 半導体製造装置

## 精密計測機器



# 従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算